

2023年半导体所拟转让专利情况公示（一）

公示时间：2023年3月23日至2023年4月6日 联系人：曹永胜 邮箱：yscao@semi.ac.cn 电话：82304880

序号	专利名称	发明人	专利号	所属研究组	研究组负责人	转让形式	拟转让的公司	拟转让金额（万元）
1	一种水平式碳化硅高温氧化装置	孙国胜;董林;王雷;赵万顺;刘兴昉;闫果果;郑柳	ZL 2012 10226334.1	分子束外延微结构材料研究组（刘兴昉）和半导体微纳工艺技术研究组（王晓东）	刘兴昉 王晓东	专利权转让	广东天域半导体股份有限公司	46.641万元
2	一种垂直式碳化硅高温氧化装置	孙国胜;董林;王雷;赵万顺;刘兴昉;闫果果;郑柳	ZL 2012 10203696.9					
3	一种超高温双层水冷石英管真空室用双密封结构	孙国胜;董林;王雷;赵万顺;刘兴昉;闫果果;郑柳	ZL 2013 10470610.3					
4	一种高温大面积碳化硅外延生长装置及处理方法	孙国胜;董林;王雷;赵万顺;刘兴昉;闫果果;郑柳	ZL 2012 10260432.7					
5	一种真空室用高温 CVD 加热线圈结构	张新河;孙国胜;孔令沂;王占国;李锡光;萧黎鑫;刘丹	ZL 2016 11251450.3					
6	一种卫星盘自转的 SiC 外延生长主盘结构	孙国胜;杨富华;宁瑾;刘兴昉;赵永梅;王占国;孔令沂;萧黎鑫	ZL 2016 21419760.7					
7	一种 8 英寸单片高温碳化硅外延生长室结构	孙国胜;杨富华;宁瑾;刘兴昉;赵永梅;王占国;李锡光;张新河	ZL 2016 21419794.6					

说明：上述 7 件专利为中国科学院半导体研究所和广东天域半导体股份有限公司共有，其中，中国科学院半导体研究所享有 30%专利权，广东天域半导体股份有限公司享有 70%专利权。经评估，7 件专利的评估值为 155.47 万元。此次转让是将 7 件专利中研究所享有的 30%的专利权转让广东天域半导体股份有限公司。研究所拟转让价格 46.641 万元。